

FB-x26 BUMP1

KAIJO

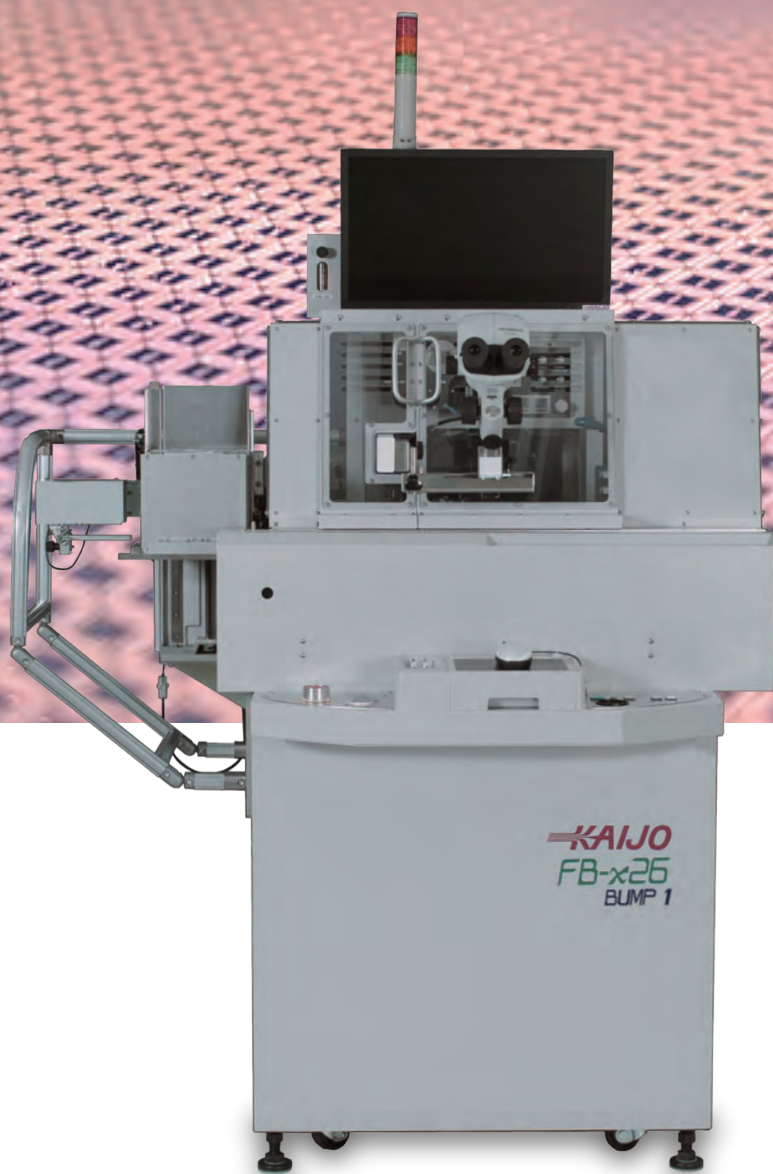
超音波併用熱圧着 (サーモソニック) 方式 高精度ハンブボンダー
Highly Accurate Thermosonic Bump Bonder



6 インチまでのウェハをマガジンから
自動で供給する BUMP ボンダー
Bump bonder with automatic wafer
supply up to 6 inches by magazine



プッシャ、及びマガジンに収容されたウェハ
Pusher, and wafer in the magazine



※オプションカバー仕様
※Specifications with optional covers

特長 / FEATURES

- 最大 6 インチまでのウェハを自動で供給 安定したウェハのハンドリングが可能
Wafers up to 6 inches can be automatically supplied, contributing to stable handling
- トレーサビリティと自己診断機能をアップグレード 品質管理と健全な装置状態の維持が容易に
Enhanced traceability and self-diagnosis function. Contribute to quality control and machine maintenance
- 高まるコネクティビティと Industry4.0 への需要に対応
SECS/GEM 標準対応 カイジョー独自のホスト管理システム "KISS" も選択可能
Ready for the growing demand of connectivity and Industry4.0 - SECS/GEM or "KISS" (Selectable)

FB-x26 BUMP1

■ 主な仕様

ボンディング性能	
ボンディング方式	超音波併用熱圧着（サーモソニック）方式
超音波発振方式	PLLによる発振周波数自動追尾、単周波
ボンディング範囲	4インチウェハ：直径 95mm 6インチウェハ：直径 145mm
繰り返し位置精度	3σ ≤ 3.0μm*
ボンディング速度	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**

画像認識機能	
認識方式	形状認識方式(α-eyes)と多値化相関処理方式から選択可
検出速度	約 100msec/2点(5mm角チップ) 約 200msec/4点(5mm角チップ)
検出率	99.9%以上**

対応ワーク	
ウェハサイズ	4～6インチ 厚さ： 0.2～ 1.0mm
キャリアテープサイズ	幅： 170mm 長さ： 170mm 厚さ： 2.0mm
マガジンサイズ	幅： 176mm 長さ： 180mm または 200mm 高さ： 170mm

外部通信機能	
	SECS / GEM 標準対応 KISS*** 標準対応 (ホストソフトウェアはオプション)

ユーティリティ	
電源	単相 AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A ※210V, 220V, 230V, 240V, 100V はオプション 最大消費電力：約 2.0kW
エア	圧力： 0.3～0.970MPa (3～9.9Kgf/cm ²)、ISOクラス5以上 消費量：40Liters/min 以下
真空	圧力： -53.32MPa 以下 (400mm/Hg 以上)

装置諸元	
寸法	幅： 1,292mm 奥行： 1,240mm 高さ： 1,728mm (警告灯上部までは 2,030mm)
重量	約 550kg

*セルフティーチ精度を除く
**当社所定の条件下での算出値
*** Kaijo Interconnecting Service System の略称

■ SPECIFICATIONS

Bondability	
Bonding method	Ultrasonic with thermocompression bonding
Oscillation system	Frequency automatic tracking by PLL. Single frequency.
Bonding area	4" wafer : Diameter 95mm 6" wafer : Diameter 145mm
Bonding Accuracy	3σ ≤ 3.0μm*
Bonding Time	30msec/bump(Pull-Cut mode)** 40msec/bump(Fix-Cut mode)**

Recognition System	
Recognition method	Shape recognition (α-eyes) or Multi-valued correlation processing (selectable)
Recognition time	Approx. 100msec/2 points (5mm square chip) Approx. 200msec/4 points (5mm square chip)
Detection rate	99.9% or more**

Applicable work size	
Wafer size	4"-6" Thickness : 0.2 ~ 1.0mm
Carrier boat size	Width : 170mm Length : 170mm Thickness : 2.0mm
Magazine size	Width : 176mm Length : 180mm or 200mm Height : 170mm

External interface	
	SECS / GEM available as standard KISS *** available as standard (Host software are option)

Utility	
Power	Single phase AC200V±5%, 50Hz/60Hz, 8A (210V, 220V, 230V, 240V, 100V option) Maximum power consumption : Approximately 2.0kW
Dry air	Pressure : 0.3 ~ 0.970MPa (3 ~ 9.9Kgf/cm ²) ISO class 5 or more Consumption : 40Liters/min or less
Vacuum	Pressure : -53.32MPa or less (400mm/Hg or more)

Dimensions	
Width	1,292mm
Depth	1,240mm
Height	1,725mm (To top of signal lamp : 2,030mm)
Weight	Approx. 550kg

* Excluding self-teach accuracy.
** Calculated value under the conditions specified by KAIJO.
*** Kaijo Interconnecting Service System



株式会社 カイジョー / KAIJO CORPORATION
東京都羽村市栄町 3-1-5 〒205-8607
3-1-5 Sakae, Hamura, Tokyo, JAPAN 2058607

URL <https://www.kaijo.co.jp>

ボンダー事業部

TEL. 042-555-6162
FAX. 042-579-5175
✉ bonder-info@kaijo.co.jp

- 国内営業 (東日本) / Domestic Sales (Tokyo)
- 国内営業 (西日本) / Domestic Sales (Osaka)
- 海外営業 / Overseas Sales
- カスタマーサポート・ヘルプデスク / Customer Support Help-desk
- 台湾海上希歩洋股份有限公司 / TAIWAN KAIJO SHIBUYA CORPORATION
- 上海楷捷半导体科技有限公司 / KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI) CO.,LTD.
- KAIJO SHIBUYA EUROPE GmbH (GERMANY)
- シブヤカイジョー(タイランド) / SHIBUYA KAIJO(THAILAND) CO.,LTD.
- シブヤカイジョー(マレーシア) / SHIBUYA KAIJO(MALAYSIA) SDN. BHD.

TEL.042-555-8889
TEL.06-4805-0231
TEL.042-555-0321 / +81-42-555-0321
TEL.042-555-4834 / +81-42-555-4834
TEL.+886-2-8712-2377
TEL.+86-21-6275-1515
TEL.+49-611-72429155
TEL.+66(0)2673-9496-8
TEL.+60(0)4-611-6040 (PENANG Office)

ご用命は